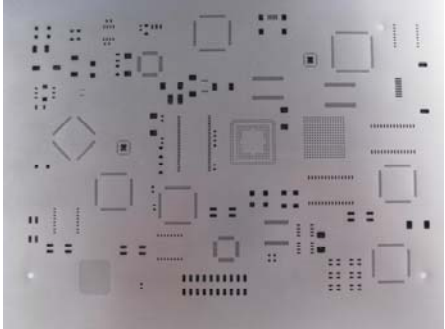
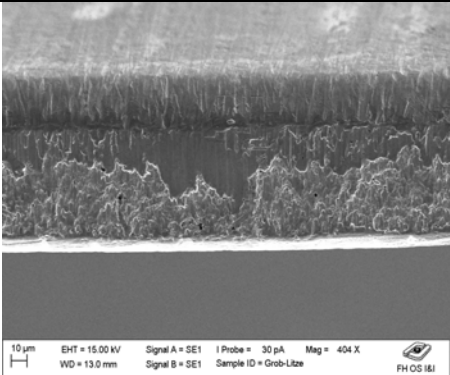
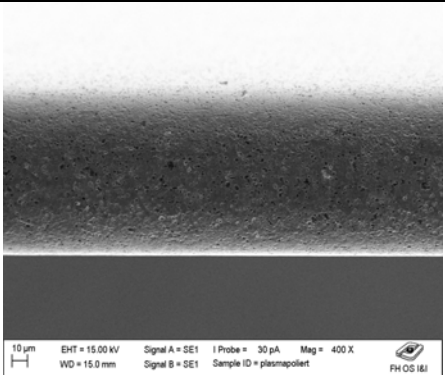
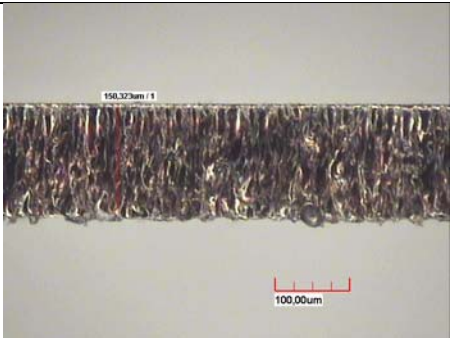
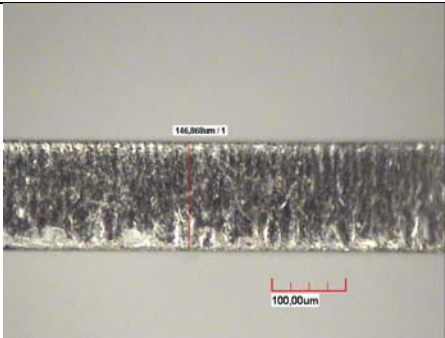


4.1 Technische Spezifikation „Plasmapolieren von Siebdruckfolien für SMD- Halbleiterindustrie“

<p>Kurzbezeichnung: Plasmapolieren von Edelstahlfolie, Materialspezifikation (z.B.1.4301), max. Foliengröße 900x900mm</p>	 <p>Bild plasotec GmbH SMD Siebdruckfolie</p>
<p>Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimale Verrundung der Pattkanten • Minimaler Materialabtrag • Entfernung von Anlauffarben und Bearbeitungsspuren der Laserbearbeitung 	
<p>Vor Bearbeitung</p>	<p>Nach Bearbeitung</p>
 <p>10 µm EHT = 15.00 kV Signal A = SE1 I Probe = 30 pA Mag = 404 X WD = 13.0 mm Signal B = SE1 Sample ID = Grob-Litze FH OS I&I</p> <p>Bild plasotec GmbH Laserschnittbild vor Bearbeitung</p>	 <p>10 µm EHT = 15.00 kV Signal A = SE1 I Probe = 30 pA Mag = 400 X WD = 15.0 mm Signal B = SE1 Sample ID = plasmapolier FH OS I&I</p> <p>Bild plasotec GmbH Laserschnittbild nach der Bearbeitung</p>
 <p>150,32µm / 1</p> <p>100,00µm</p> <p>Bild plasotec GmbH Laserschnittbild vor Bearbeitung</p>	 <p>146,80µm / 1</p> <p>100,00µm</p> <p>Bild plasotec GmbH Laserschnittbild nach Bearbeitung</p>
<p>Vorteile/Ergebnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pattkanten haben definierte Kantenverrundung • Hohe Stabilität der Lotpaste auf der Leiterkarte • Keine Verluste an Materialstärke der Folie • Laserschnittkanten sind frei von allen Bearbeitungsrückständen 	